



第39回春季講演大会

日時：2025年3月11日(火)～13日(木)

場所：拓殖大学 文京キャンパス E館5階6階（茗荷谷駅）

【ハイブリッド開催：オンライン視聴可能】

交流会：2025年3月12日17:30から B館地下学生食堂（オプション申込必要）

詳細情報：<https://jiep.or.jp/event/convention/jiep2025s/index.php>



参加(聴講)登録

特別講演 3月12日(水) E館1階 講堂

【1】 14:45～15:45

「緊迫化する中台関係と日本外交」

拓殖大学 政経学部 教授

丹羽 文生 氏

東南アジア近辺を中心とした地域において、中国が影響力拡大を目指し、軍事的・経済的活動を活発化させている。中でも、軍事的脅威に晒されているのが、中国が「核心的利益」としている台湾である。台湾の動向は日本に大きな軍事的・経済的影響を与える。近年の、台湾・香港を含む東南アジアでのフィールドワークによる知見から、「アジアに迫る危機」「日本外交」について述べる。



【2】 16:00～17:00

「Empowering AI Innovation with Versatile and Open-source RISC-V Processor」

Tenstorrent Japan KK Country Manager, Japan

中野 守 氏

Tenstorrent Inc, RISC-V Architect Gr Fellow

石井 康雄 氏

LLMをはじめとする近年のAIテクノロジーは高い演算性能・メモリアクセス性能に支えられており、その性能要求はますます高まっている。本発表では演算性能・メモリアクセス性能を実現するテントレント社のRISC-V・AIテクノロジーに関して説明をし、AIプロダクトの肝となるRISC-VベースのアクセラレータIP(Tensix)とCPU IP(Ascalon)について紹介をし、これらのIPがAIハードウェアの中でどのように活用されるかを説明する。



◆表彰式 MES2024受賞 12件 3月12日(水)14:00～14:30 講堂 (1階E101)

◆受賞講演 MES2024 ベストペーパー賞 講演 5件 3月12日(水)9:30～11:30 C会場 (6階606)

黒沢憲吾 氏 (秋田県産業技術センター)、川上雄介 氏 (㈱ニコン)、荻谷義治 氏 (芝浦工業大学)代理
小池美夏 氏 (ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱)、荒尾修 氏 (㈱デンソー)

第39回 エレクトロニクス実装学会 春季講演大会

◆チュートリアル講演 6件 3月11日(火) 10:30~16:15 D会場 (6階608)

「電子回路実装技術の役割、人材と将来」
「変化し続けるプリント配線板、ガラスコアサブストレート」
「電子機器の高機能化、応用拡大で、半導体・配線板構造が変わる！」
ー 電子機器実装の狙うべき方向を探る ー
「Society5.0時代のセンサ~IoTから人間拡張まで~」
「光電子集積化の動向と課題」
「SiCはパワーデバイス主要基板としての地位を確立したか?」

国立大学法人 横浜国立大学 羽深 等 氏
よこはま高度実装技術コンソーシアム 八甫谷 明彦 氏
よこはま高度実装技術コンソーシアム 本多 進 氏
AKKODiSコンサルティング株式会社 谷本 琢磨 氏
アイオーコア株式会社 竹村 浩一 氏
よこはま高度実装技術コンソーシアム 宮代 文夫 氏

◆スマートプロセス学会 第24回 有機/無機接合研究委員会講演 4件 3月13日(木)13:40~16:30 A会場

「半導体後工程向け低誘電・高柔軟・感光性ポリイミド組成物の開発」
「量産実績を持つ OKI独自の異種材料接合技術 CFBとその未来への展望」
「炭素繊維強化プラスチックとシラン処理アルミニウム合金の熱圧接合強度に及ぼす熱条件の影響」
「大気圧低温プラズマを用いた異種材料間の接着性向上」

荒川化学工業株式会社 山口 貴史 氏
沖電気工業株式会社 鈴木 貴人 氏
大阪大学 O李蔚豪 氏, Peihao GENG 氏, 麻寧緒 氏
東芝インフラシステムズ株式会社 山崎 顕一 氏

◆依頼講演 11件予定

●材料技術&環境調和型実装技術 ●マイクロメカトロニクス実装技術 ●配線板とその製造技術 ●電子部品・実装技術
●最先端めっき実装技術 ●カーエレクトロニクス実装 ●光回路実装技術 ●部品内蔵・検査技術:2件 ●ヘルスケア:2件

◆ポスター 9件 ポスターコアタイム: 3月12・13日昼休憩時間 5階507

●材料技術: (株)日立製作所、日本山村硝子(株)、日東紡績(株)、日鉄ケミカル & マテリアル(株) ●配線板とその製造技術: (株)シミス、(株)メイコー
●マイクロメカトロニクス実装技術: 東北大学大学院・産業技術総合研究所、東北大学 ●最先端めっき実装技術: ウシオ電機(株)

◆一般講演 110件

	A会場 (E館5階506)	B会場 (E館5階508)	C会場 (E館6階606)	D会場 (E館6階608)
3月11日	配線板とその製造技術	インテリジェント実装設計技術	高速高周波・電磁特性・回路技術	チュートリアル講演
	信頼性解析技術	マイクロメカトロニクス実装技術		
	材料技術&環境調和型実装技術			
3月12日	高速高周波・電磁特性・回路技術	電子部品・実装技術1	MES2024 BP賞 講演	企業プレゼンテーション
3月13日	最先端めっき実装技術	サーマルマネジメント &	3D・チップレット技術	カーエレクトロニクス実装
	スマートプロセス学会	パワーエレクトロニクス実装	部品内蔵・検査技術	ヘルスケア・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス
				光回路実装技術

◆参加費 聴講(参加)費、論文データのダウンロード、オンライン視聴含む (消費税込)

会員	正会員	17,000円	賛助会員	賛助会員	17,000円	非会員	一般	30,000円
	海外会員	17,000円		クーポン	使用可(1枚)		学生	5,500円
	若手会員	17,000円		一般	17,000円		※参加費には食事代は含まれておりません。	
	シニア会員	9,000円		学生	3,500円			
	学生会員	3,500円		一般	22,000円			
	名誉会員	無料		学生	4,500円			

オプション申込	
交流会	5,000円
論文集冊子版	3,000円

※論文集冊子版は国内発送のみ

◆企業展示 23社 展示コアタイム: 12・13日昼休憩時間

企業プレゼン: 7社 3月12日(水)午前 D会場

(株)構造計画研究所 奥野製薬工業(株) (株)先端科学シミュレーション 研究所

構造計画研究所 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. OKUNO CHEMICAL INDUSTRIES CO. LTD. 奥野製薬工業株式会社

丸文(株) オムロン(株) ウシオ電機(株)

Marubun Since 1844 OMRON USHIO

日産化学(株) (株)三ツワフロンテック マイクロウェーブファクトリー(株)

日産化学株式会社 株式会社 三ツワフロンテック Microwave Factory Co., Ltd.

(株)図研 日本高純度化学(株) サカタインクス(株)

ZUKEN 日本高純度化学株式会社 SAKATA INX Visual Communication Technology

キーサイト・テクノロジー(株) タカヤ(株) (株)堀場製作所

KEYSIGHT TAKAYA HORIBA

ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン(株) I-PEX(株)

SONY Sony Semiconductor Solutions Waters TA Instruments I-PEX

COMPOROID サーマグラフィティクス (株)日立ハイテク

COMPOROID サーマグラフィティクス HITACHI Inspire the Next

電子科学(株) レーザーテック(株)

ESCO 電子科学株式会社 Lasertec

【協賛団体】予定 IEEE EPS Japan Chapter, 映像情報メディア学会, 化学工学会, KEC 関西電子工業振興センター, 色材協会, 精密工学会, 電気化学会, 電気学会, 電子情報技術産業協会, 電子情報通信学会, 日本印刷学会, 日本機械学会, 日本光学会, 日本接着学会, 日本電子回路工業会, 日本電子材料技術協会, 日本時計学会, 日本熱物性学会, 日本ロボット工業会, 日本溶接協会, 光産業技術振興協会, 表面技術協会, 粉体粉末冶金協会, 溶接学会, レーザ加工学会, YUVEC, YJC



主催: 一般社団法人 エレクトロニクス実装学会
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2
お問合せMail: E-mail: taikai39@jiep.or.jp
ホームページ: <https://jiep.or.jp>



共催

